

Datenblatt

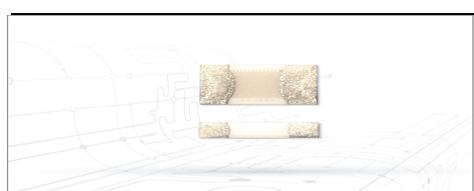
08x05SMDPt100B-C

181008

Kurzbeschreibung

Dieser Platin-Chip-Temperatursensor zeichnet sich durch seine geringe Baugröße aus und kann deswegen eine sehr hohe Bestückungsdichte zulassen. Er wird bevorzugt für die automatisierte Bestückung eingesetzt, z.B. von elektrischen Leiterplatten in Großserienkonfektion.

Maße in mm

	L	B	H	Lötanschluss
	2,0 ±0,2	1,3 ± 0,2	0,5 ±0,2	Ca. 0,4

Technische Daten

Nennwiderstand R ₀ bei 0°C	Spezifikation	Toleranz	Bestellnummer	Artikelnummer
100 Ω	DIN EN 60751	F 0,3 (DIN B)	08x05SMDPt100B-C	181008

Temperaturbereich:	-50 °C bis +150 °C im Dauerbetrieb Gültigkeit der Toleranz F 0,3: -50 °C bis +150 °C		
Temperaturkoeffizient:	TK = 3850 ppm/K		
SMD Baugröße:	entsprechen den Normen CECC 40401-004/DIN 45921		
Verarbeitung:	Reflowlöten (Löttemperatur/-zeit ≤ 240°C/8s) Schwall-Wellenlöten (Löttemperatur/-zeit ≤ 260 °C /10 s)		
Lötanschlüsse:	galvanisch verzinnete Rundumkontaktierung mit Diffusionssperre		
Einsatzbedingungen:	Der Sensor darf nicht ungeschützt in feuchter Umgebung oder aggressiver Atmosphäre eingesetzt werden.		
Langzeitstabilität:	max. R ₀ -Drift ≤ 0,05 % /Jahr		
Isolationswiderstand:	>10 MΩ bei Raumtemperatur		
Erschütterungsfestigkeit:	DIN EN 60751, Abs. 4.4.2.		
Selbsterwärmung:	0,15 K/mW		
Ansprechzeit:	Bewegtes Wasser (v=0,4 m/s):	τ _{0,5} =0,1 s	τ _{0,9} =0,3 s
	Luftstrom (v=1 m/s):	τ _{0,5} =2,6 s	τ _{0,9} =7,9 s
Verpackung:	gegurtet		
Hinweis:	Bitte beachten Sie unsere Einsatz- und Einbauhinweise.		
RoHS konform			

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle technischen Angaben sind Beschaffenheitsangaben und sichern keine Eigenschaften zu.

Version 1.0 vom 01/2007

